将克

正彦

アルミニウム合金束線材とアルミニウム合金板材の超音波接合

日大生産工

ユウアイ電子工業(株)

1.緒言

自動車等の軽量化を目的に材料置換が検討されている機能部材に電気配線材がある.電気配線 材は、銅材料からアルミニウム材料へ、単線材から 東線材や撚線材に材料置換することで軽量か つ大電流化が検討されている.銅製電気配線材の 接続方法は、かしめやはんだ付けによる接続が一 般的である.しかし、アルミニウム線材の各素線 表面を覆う酸化膜により従来の接続法では高い 接触抵抗が生じてしまう.

超音波接合法は接合過程において酸化膜の破 壊・除去ができるため電子デバイスのアルミニウ ム配線接続に用いられている.そのため、単線材 の超音波接合に関する研究報告は多いが、束線 材・撚り線材の超音波接合に関する研究報告は少 ないのが現状である.そこで著者らは、先に二本 束線材を横並びに配置し板材と超音波接合を行 い束線材と板材の超音波接合が可能であること を報告した¹⁾.しかし、用いられる束線材・撚線 材については積み重ねた線材の超音波接合に関 する検討も必要であると考える.

本研究では,三本束線材を俵積み配置し板材と 超音波接合を行った.線材と板材の接合および線 材同士の接合状態,線材の変形挙動に対して接合 条件が及ぼす影響を比較した.

2.供試材および実験方法

線材には素線径 0.32mm のアルミニウム合金 線材,板材には厚さ 0.6mm のアルミニウム合金 板材を供試材とした.線材は三本を俵積み配置し, 接合を行った.

接合は先端に平面形状を有する超硬合金製ウ ェッジツールを装着した 60kHz 超音波接合装置 を用いた.接合は予備実験より選定した Fig.1に 示す接合シーケンスおよび Table 1に示す接合条 件で行った.接合中はツール上方からレーザー変 位計によるツール押込量 ΔZ の計測を行った.得 られた継手の外観および接合面に対して垂直な 横断面を光学顕微鏡で観察し,接合条件が線材の 接合状態および変形挙動に及ぼす影響を比較・検



(院)〇石井 翔太,前田

裕之, 塩田

内田

Fig. 1 Ultrasonic bonding sequence. (1) The start of the bonding force loading, (2) the bonding force reaches the set value, (3) the start of the application of ultrasonic vibration, (4) the end of application of the ultrasonic vibration, and (5) unloading of the bonding force.

Table 1 Ultrasonic bonding conditions.

Parameters	Symbol	(unit)	Value / Range
Frequency	f	(kHz)	60
Ultrasonic power	Р	(W)	1.0 ~ 5.0
Bonding load	F	(N)	1.0 ~ 5.0
Ultrasonic time	tu	(s)	0.01~0.4
Number of wires	Ν	(-)	3



Ultrasonic Bonding of Aluminum Bundled Wires and Aluminum Plates

Shota ISHII, Masakatsu MAEDA, Hiroyuki UCHIDA and Masahiko SHIODA

討した.

3. 実験結果および考察

Fig.2に超音波出力を変化させたときのツール 押込量の測定結果を示す.ツール押込量の最大 値は超音波出力の増加に伴って大きくなる傾向 が観察された.超音波振動印加工程において ΔZ の推移に複数の変曲点が観察された.これは三本 束線材の接合が達成できたすべての条件に観察 された.Fig.3に一例として接合荷重 F=4.0N, 超音波出力 P=4.0W の条件で超音波振動印加中

における ΔZ の経時変化を示す. 超音波振動印加 開始後から停止までの間において図中に矢印で 示した 2 度のツール押込量の変曲点が観察され た. このことは, 接合が一度に達成されるのでは なく, 複数回に分かれ, 段階的に接合が進行する ためと考える.

Fig. 4に超音波振動印加時間を変化させたときの接合後のツール外観を示す. 超音波振動印加時間 tv=0.01sではツールに上部線材のみが凝着して持ち上がった. 超音波振動印加時間 $tv=0.02\sim0.06s$ では三本の線材がツールに凝着して持ち上がった. 超音波振動印加時間 tv=0.06s以降では線材と板材と接合された. このことは、超音波振動印加時間により接合が段階的に進むことを示している.

Fig.5に超音波振動方向に対して垂直な横断面 の観察結果を示す.超音波出力の増加に伴い圧下 量が増えている.全ての条件において下部線材の 線材間(W/W)接合は確認されなかった.下部線材 同士には相対運動が働かなかったためである.一 方,上部線材と下部線材のW/W 接合と下部線材 と板材(W/P)の接合幅を比較すると W/W の接合 幅の方が大きい.これは線材同士が接合された後, 線材と板材が接合されたことを示している.また, 上部線材と下部線材の形状を比較すると下部線 材は円形断面をほとんど維持しているが,上部線 材は超音波出力の増加に伴い下部線材に沿って 変形している.

Fig.6に線材の断面積を示す.下部線材は二本 あるため測定後の平均値である.超音波出力の増 加に伴い断面積は減少する.これは、ばりによる ものである.下部線材の断面積はほとんど変化し ない.このことから、変形の多くが上部線材の変 形によるものであるためと考える.

参考文献

1) 石井翔太ほか: 軽金属学会第 136 回春期大会 講演概要, (2019), pp. 205-206.



Fig. 3 Position of the wedge-tool during application of ultrasonic vibration. (F=4.0N , P=4.0W)



Fig. 4 Appearance of wedge-tool after ultrasonic bonding of AI wire to AI plate at various time. (*F*=4.0N , *P*=4.0W) *P*=2W *P*=4W



Fig.5 Observation of cross sectional-view of bonding joints of AI wire to AI plate at various ultrasonic power. (F=4.0N, t_{u} =0.3s)

